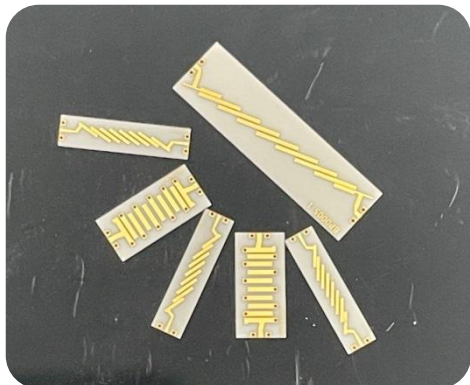


### 薄膜微带滤波器



#### 应用：

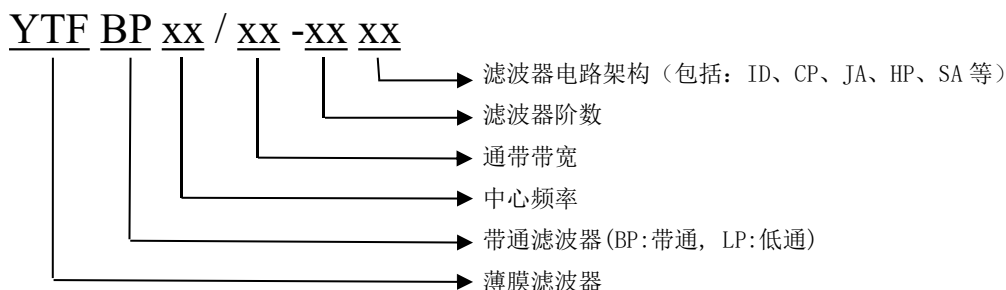
- 微波通信
- 雷达
- 电子对抗

薄膜微带滤波器是一种体积小、重量轻，能有效分离不同频率信号的器件。具有工作频带宽、带外抑制好、插入损耗小等优点，在系统中用于控制信号的频率响应，可以使有用信号通过，无用信号滤除，在微波电路系统中应用广泛。

#### 特点：

- 小型化；
- 高可靠性；
- 温度范围宽；

#### 产品命名规则



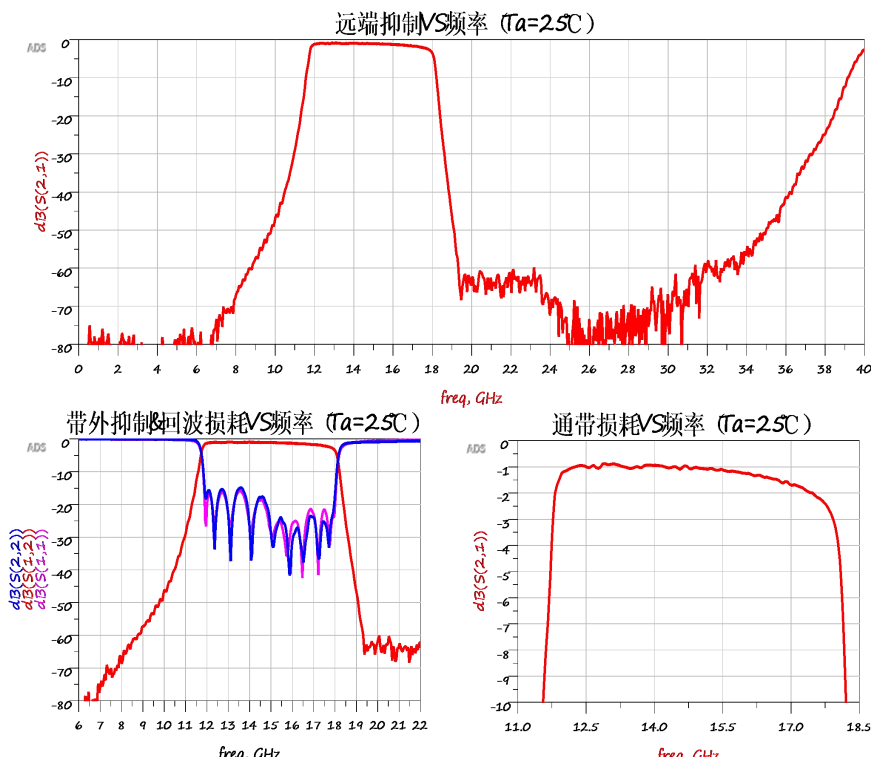
#### 主要参数 (T<sub>A</sub>=25°C)

| 项目                  | 技术指标                              | 单位  |
|---------------------|-----------------------------------|-----|
| 中心频率 f <sub>0</sub> | 14.75                             | GHz |
| 通带频率范围              | 12.0~17.0                         | GHz |
| 中心损耗                | ≤3.0                              | dB  |
| 带外抑制                | ≥55dBc@8.0GHz;<br>≥55dBc@21.0GHz; | dBc |
| 带内驻波比               | ≤1.8                              | -   |

#### 其他参数

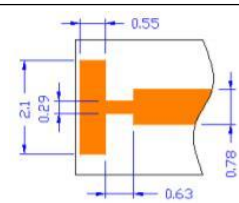
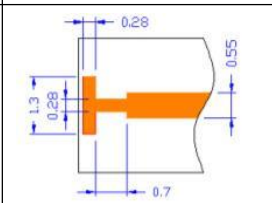
|        |              |
|--------|--------------|
| 工作温度   | -45°C~+85°C  |
| 存储温度   | -55°C~+125°C |
| 最高输入功率 | 35dBm        |
| 输入输出阻抗 | 50 欧姆        |
| 输出安装方式 | 键合           |

### 典型性能测试

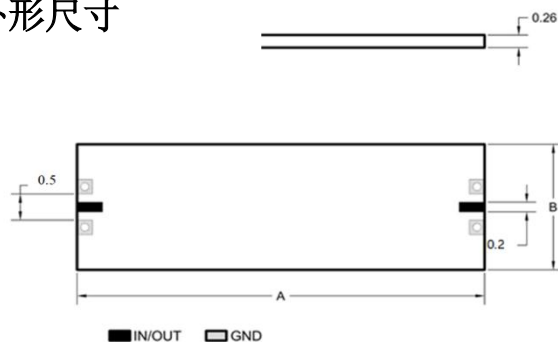


### 注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.2mm左右，表面距离上盖板2mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/°C）相当的载片上，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

| 电路板Rogers5880厚10mil                                                                 | 电路板Rogers4350厚10mil                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 适用频率：DC-38GHz                                                                       | 适用频率：DC-32GHz                                                                       |
| 注：T型图形顶端基板白边50um；频率10GHz以下无需匹配                                                      |                                                                                     |

### 外形尺寸



| 尺寸单位 | mm                                           |
|------|----------------------------------------------|
| 标识尺寸 | A: 7.0、B: 2.5 (A、B外形公差: $\pm 0.1\text{mm}$ ) |
| 基板材料 | 陶瓷                                           |
| 表面处理 | 镀金                                           |

### 建议装配图

